
南亞電路板股份有限公司 2025年上半年營運概況

2025年09月04日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 2025年營運策略



公司概況

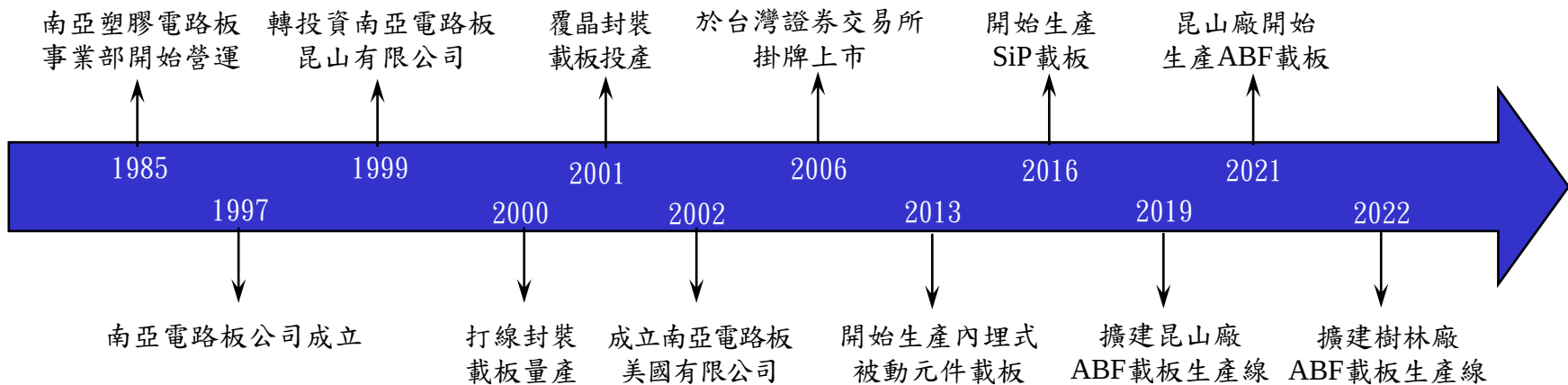
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2025年上半年合併營業額為新台幣 180.4億元。
- 台股上市市值：新台幣723.7億元(2025年06月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概况

歷史沿革



- 1985：南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997：經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999：轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000：進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001：進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002：成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006：正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013：產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016：開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019：因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021：昆山廠開始生產ABF載板
- 2022：樹林廠開始生產ABF載板



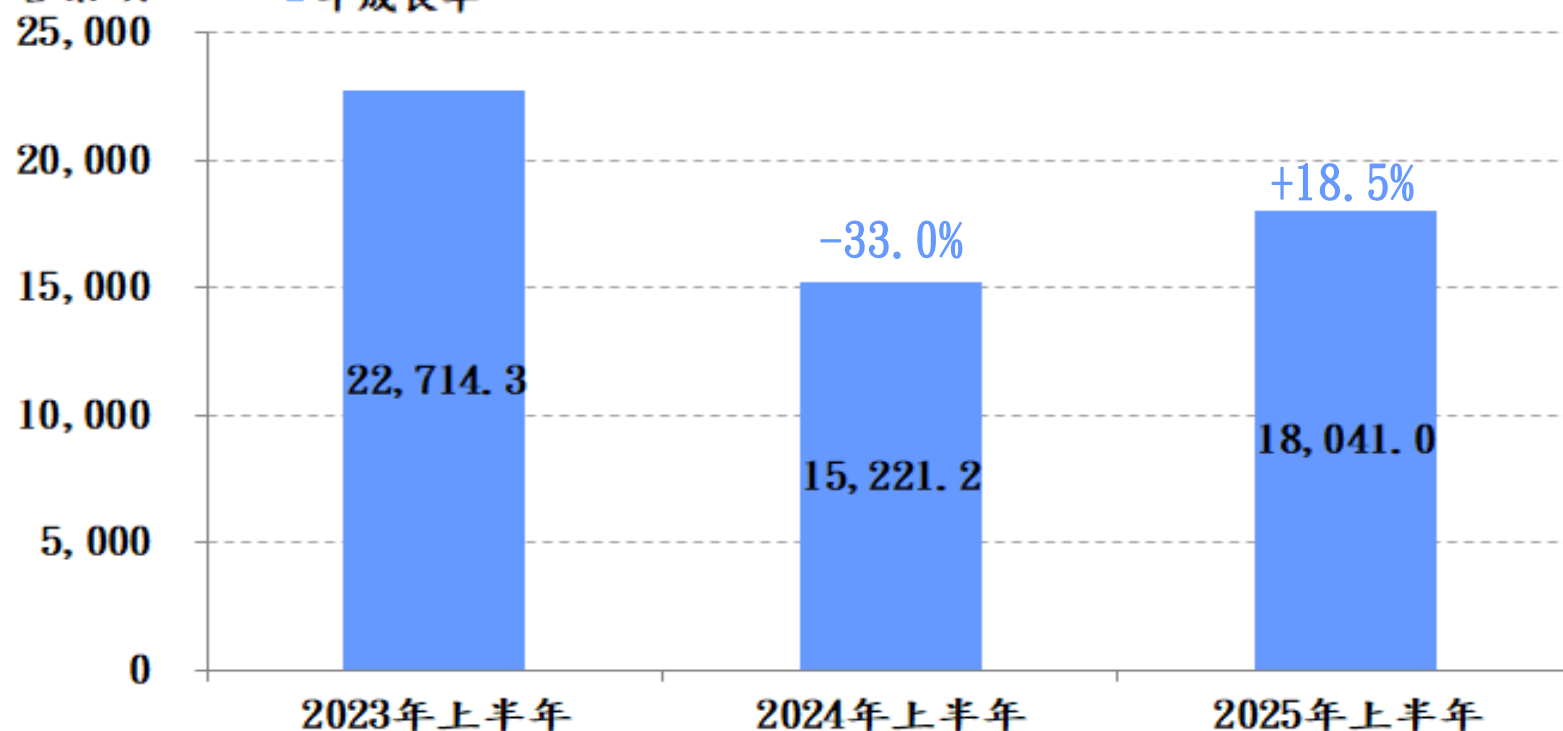
財務狀況

近三年合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

■ 年成長率

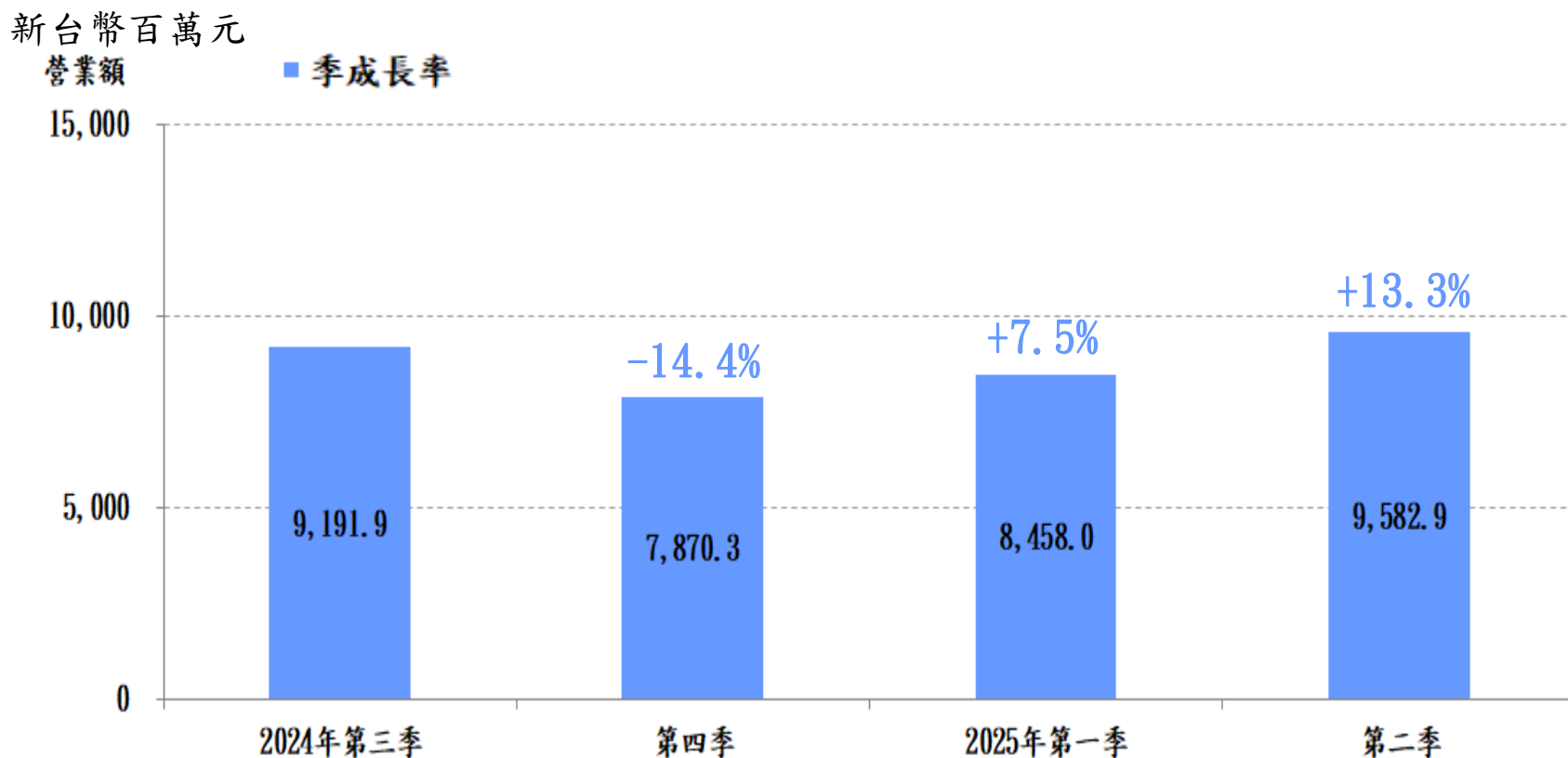


- 2024年上半年營收較2023年同期減少33.0%:
網通產品持續庫存調整，2024年上半年營收比2023年同期下滑。
- 2025年上半年營收較2024年同期增加18.5%:
資料中心升級網通設備與消費性電子提前備貨，相關產品需求提高，2025年上半年營收比2024年同期提高。



財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

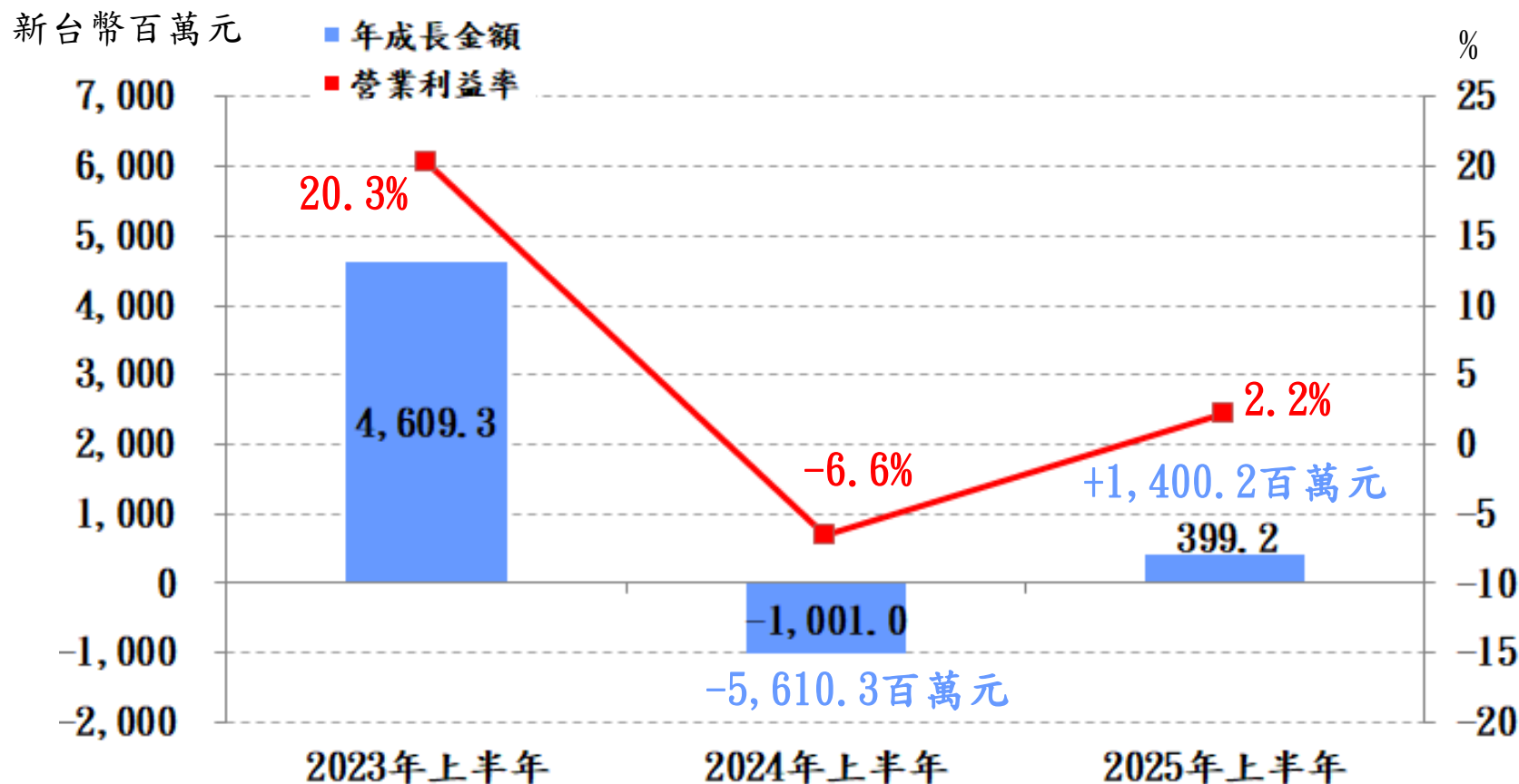


- 2024年第四季營收較2024年第三季減少14.4%:
因消費性電子淡季，PC、遊戲機需求降低，營收比第四季減少。
- 2025年第一季營收較2024年第四季增加7.5%:
資料中心對網通產品的需求提高，致第一季營收比第四季成長。
- 2025年第二季營收較2025年第一季增加13.3%:
雲端與邊緣運算產品需求再提升，使第二季營收比第一季增加。



財務狀況

近三年營業利益

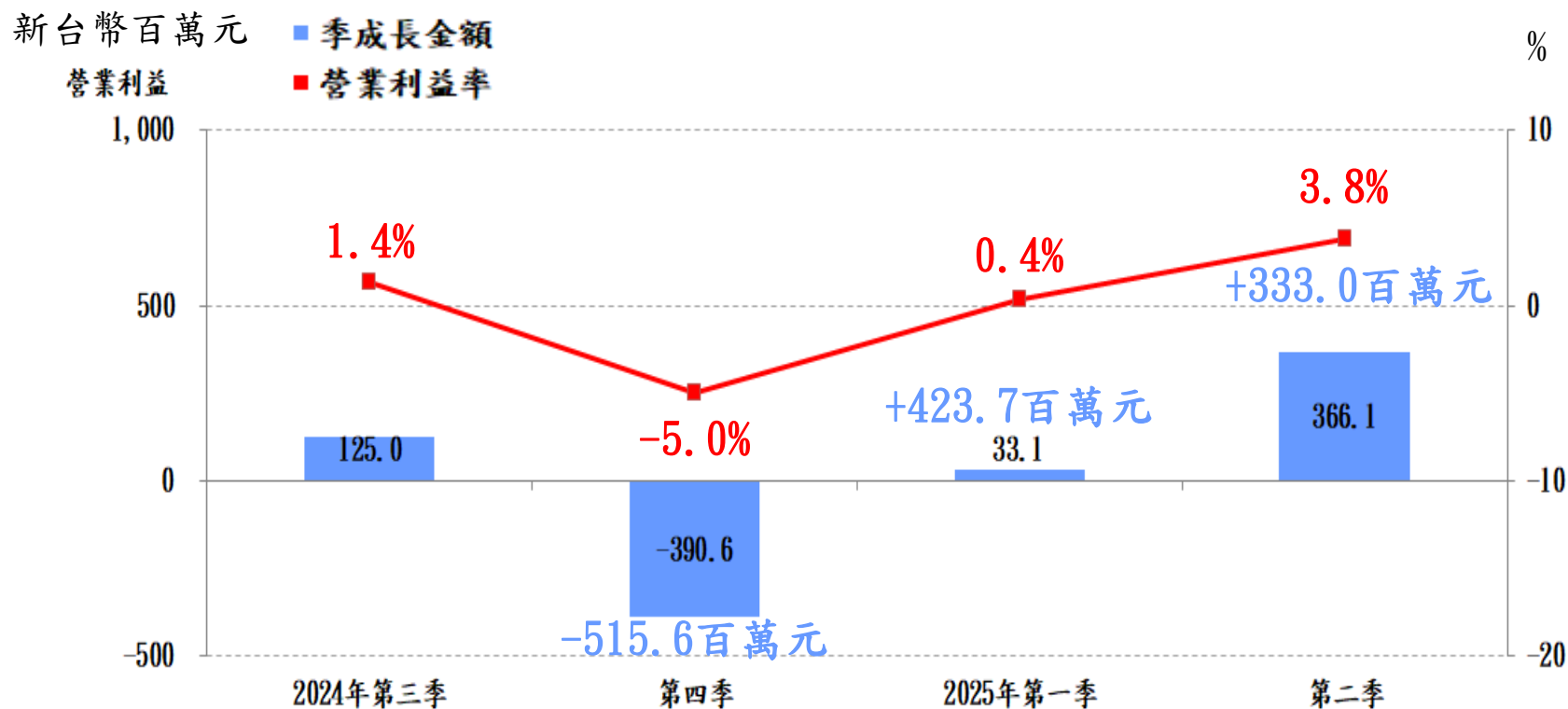


- 2024年上半年營業利益較2023年同期減少5,610.3百萬元：
因網通產品需求疲弱，營收規模縮小，致營業利益減少。
- 2025年上半年營業利益較2024年同期增加399.2百萬元：
營收規模擴大，且產品組合改善，致營業利益增加。



財務狀況

近一年每季營業利益

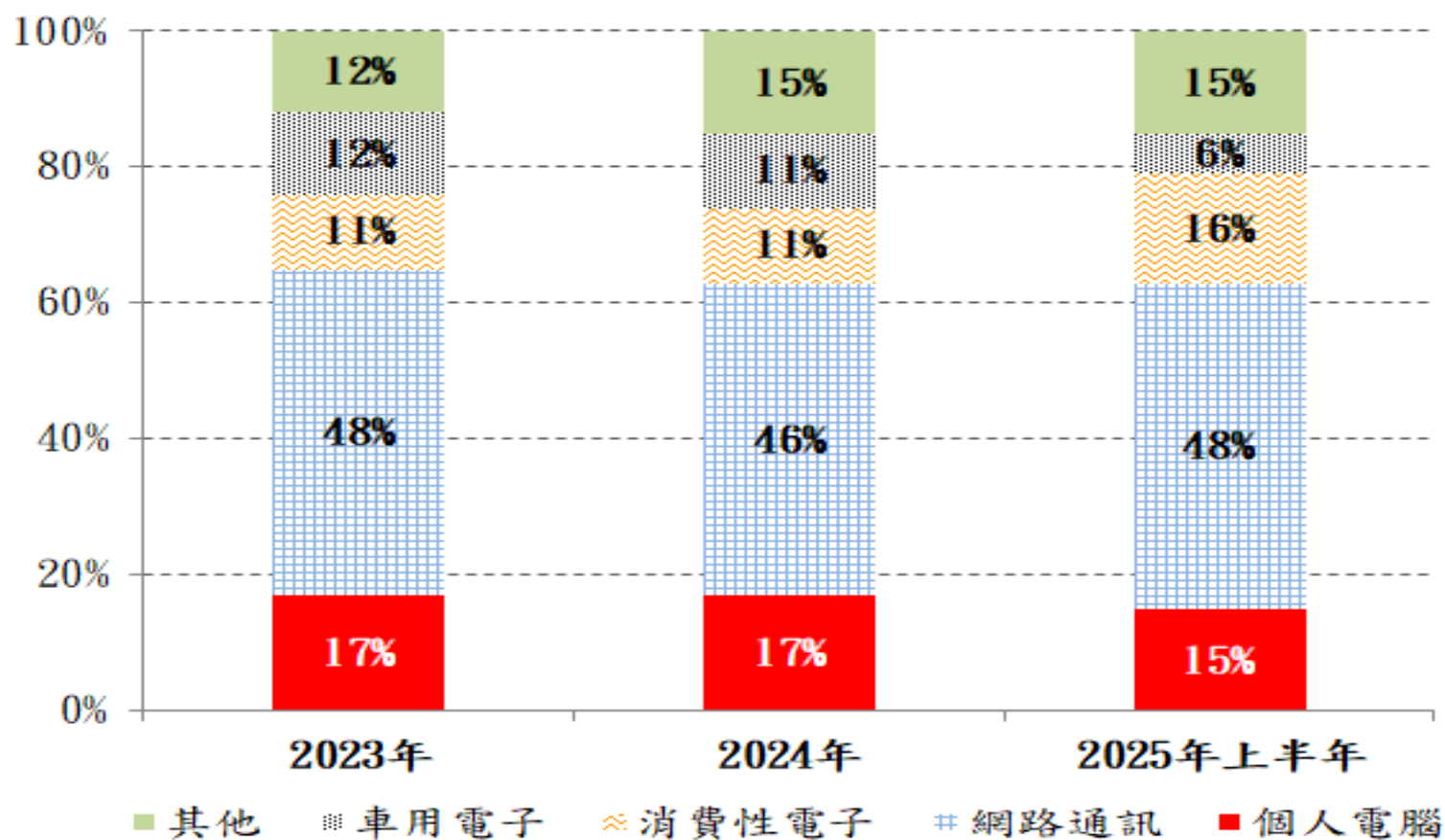


- 2024年第四季營業利益較2024年第三季減少515.6百萬元：
受消費性電子淡季影響，營收規模縮小，第四季營業利益比第三季減少。
- 2025年第一季營業利益較2024年第四季增加423.7百萬元：
高階網通產品銷售提升，致第一季營業利益比第四季增加。
- 2025年第二季營業利益較2025年第一季增加333.0百萬元：
高階雲端與邊緣運算應用產品需求提升，第二季營業利益再提高。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

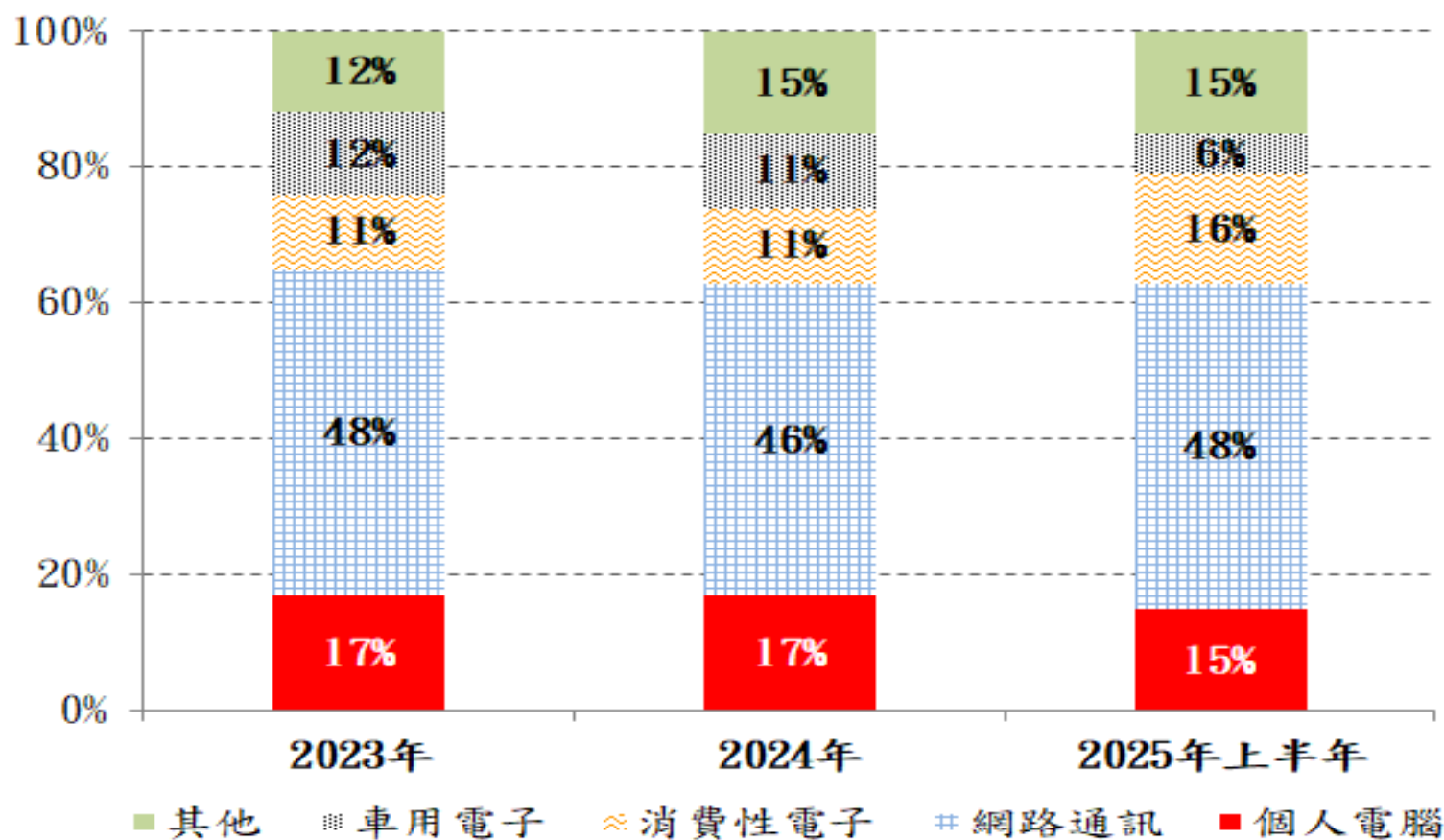


- 個人電腦受傳統銷售淡季影響，2025年上半年相關營收比重降低。
- 受益於資料中心升級網通設備，高階交換器需求提升，帶動2025年上半年網通營收比重提升。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 消費性電子客戶提前備貨，降低關稅提高風險，致2025年上半年相關營收提高。
- 汽車價格競爭嚴重，供應鏈亦受影響，致2025年上半年營收比重降低。
- 人工智慧與高效運算產品需求相對穩健，2025年上半年營收比重持平。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ ABF載板

將與客戶緊密合作，開發人工智慧(AI)交換器、AI路由器、AI伺服器處理器、收發器模組晶片、無線網路晶片、5奈米先進駕駛輔助系統處理器、智能座艙、高階掌上遊戲機處理器及數位電視晶片等應用載板，強化產品組合。

■ BT載板

本公司將開發新世代行動裝置的主機板、相機感測器等系統級封裝載板，同時爭取多種應用的網通商機，如：5G天線模組、5G光通訊收發模組、低軌衛星接受器等應用載板；另外也將量產車用處理器與可程式邏輯晶片載板。

■ 一般電路板

資料中心伺服器帶動HDI與多層板需求，本公司將開發並量產AI伺服器顯示卡、新世代伺服器網通卡；此外也針對各類邊緣AI產品商機，將量產高階PC與車用毫米波雷達應用電路板，使產品更加多元化。



2025年營運策略

公司執行四大轉型以提升競爭力

- 產品轉型：提升高值化、差異化產品比重，拓展新應用及市場。
- 事業轉型：開發新材料、新技術及新產品，深化公司產業佈局。
- 數位轉型：應用數位科技，精進AI及數位轉型，實現智能化營運。
- 低碳轉型：擴大綠電使用，致力節能減碳，落實循環經濟推動。



感謝您的聆聽

